

【商品重要訊息】

(一)軟銀公司解除軟銀集團優先無擔保債務之擔保事件說明如下：

1. 軟銀集團旗下日本電信事業軟銀公司上市計畫於 107 年 11 月 12 日獲東京證券交易所核可，預定將於 107 年 12 月 19 日掛牌上市。由於此案規畫籌資 2.4 兆日圓，預料將創日本史上最高募資紀錄，並躋身全球規模最大首度公開發行案之一。
2. 由於軟銀公司分拆上市，軟銀集團於 107 年 11 月 20 日宣布解除軟銀公司對流通在外之軟銀集團優先無擔保債之擔保義務。
3. 本次事件後軟銀集團發行機構信用評等並無變動(穆迪/Ba1，標準普爾/BB+，穆迪/無)，債券信用評等亦無變動(穆迪/Ba1，標準普爾/BB+，惠譽/無)，原保證機構軟銀公司則無信用評等。故雖保證機構解除擔保義務，預期對軟銀集團優先無擔保債影響不大。

(二)受影響商品如下：

1. 軟銀集團可提前買回美元半年配息公司債(商品代號：BD010012)
2. 軟銀集團美元半年配息公司債(商品代號：BD171202)